A股代码：688347　A股简称：华虹公司　公告编号：2026-020
港股代码：01347　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,661.14万元。

经公司董事会决议，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。同行业竞争对手每年都将大量资金投入新厂基建、产能扩充和产品研发。在此背景下，公司需要投入大量资金用于扩充产能、提升技术水平和研发能力以保持足够的技术竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于产能扩张期，提高产能供给能力和加大工艺研发力度的重要发展阶段。公司紧紧围绕整体发展战略，持续实践先进“特色IC+功率器件”工艺布局，持续为客户及市场提供丰富的产品选择。公司会始终以持续盈利为目标，不断提高经营管理水平，持续不断的进行技术突破，巩固并提升市场占有率，在保持合理毛利的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

报告期内，公司全年实现营业收入1,729,145.07万元人民币，实现归属于上市公司股东的净利润37,661.14万元人民币。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、项目建设及设备购置等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）中小股东参与现金分红决策

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，满足业务规模的增长需求，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开董事会会议，审议通过了公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东周年大会审议，经批准后实施。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026年3月27日

A股代码：688347　A股简称：华虹公司　公告编号：2026-017
港股代码：01347　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元（含税）后，募集资金净额为2,092,067.70万元，上述资金于2023年7月31日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第60985153_B02号”验资报告）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减：支付发行费用	−1,226.97
减：募投项目累计支出金额	−1,483,969.59
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,458.93
期末募集资金专户余额	630,503.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金管理协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2023年7月，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造（无锡）有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	存款方式	金额（人民币万元）	备注
招商银行股份有限公司上海分行	NRA999017055210902	活期存款	308,313.38	
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款	7,666.22	
国家开发银行上海分行	310001090000000100092	活期存款	1,920.21	
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161936099999988	活期存款	152,119.50	
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款	154,396.94	
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161936099999998	活期存款	−	已销户
国家开发银行江苏省分行	321001090000000000037	活期存款	2,200.66	
交通银行股份有限公司无锡分行	322006060013001312349	活期存款	1,906.27	
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款	713.96	
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款	1,266.63	
合计			630,503.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证等结算方式，以自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额支付，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华虹半导体有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度华虹半导体有限公司募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026年3月27日

附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年度
单位：人民币万元

募集资金净额				2,092,067.70		本年度投入募集资金总额					67,492.92		
变更用途的募集资金总额				−		已累计投入募集资金总额					1,483,969.59		
变更用途的募集资金总额比例				−									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
华虹制造（无锡）项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,679.64	1,236,651.71	−13,348.29	98.93	不适用	不适用	不适用	否	
8英寸工艺优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	23,326.75	49,666.21	−150,333.79	24.83	不适用	不适用	不适用	否	
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	41,483.76	97,606.37	−152,393.63	39.04	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2.77	100,045.30	45.30	100.05	不适用	不适用	不适用	否	
超额募集资金	否	−	292,067.70	292,067.70	−	−	−292,067.70	−	不适用	不适用	不适用	否	
合计	−	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	67,492.92	1,483,969.59	−608,098.11	70.93	−	−	−	−	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况				详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况									

注1：补充流动资金截止2025年末累计投入金额超出该募集资金总额45.30万元，系募集资金专户产生的利息。

证券代码：688347　证券简称：华虹公司

华虹半导体有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及管治报告全文。

2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688347
公司简称	华虹公司
公司名称	华虹半导体有限公司
报告范围	本报告与本公司2025年年报相辅相成。华虹半导体涉及生产制造的工厂包括上海基地及无锡基地，上海基地涵盖华虹一厂、华虹二厂、华虹三厂；无锡基地涵盖华虹七厂及华虹九厂。
时间范围	披露本公司从2025年1月1日起至2025年12月31日止（“本年度”）于环境、社会和管治方面的管理方法、举措及绩效表现。
编制依据	本报告依据香港交易所刊发的《上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》（2025年1月1日起生效版）》、上海证券交易所刊发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月）、上海市国有资产监督管理委员会（“上海市国资委”）印发的《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》，参考国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会[提示：请完整列示治理体系组成机构]

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次发布环境、社会及管治报告

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：董事会是公司ESG管理的最高决策/管理机构；监督公司ESG目标的制定和实施，包括：制定公司ESG管理绩效目标；监督目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及高级管理层	公司治理 风险合规管理 商业道德 产品和服务安全与质量	财务报告、业绩报告、上证e互动、邮件、路演 风险管理体系 反腐败机制 全方位审计 质量评审
客户	信息安全与隐私保护 产品和服务安全与质量 研发创新与知识产权保护 绿色产品 清洁技术机遇 循环经济	信息安全管理体系（ISMS） ISO9001等质量管理体系认证 客户满意度调查 技术研讨会、行业交流会 产品全生命周期管理
员工	员工权益及福利 员工健康与安全 员工发展与培训	员工权益保障体系 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 覆盖全层级的员工培训课程
政府及监管机构	合规经营 排放物与废弃物管理 能源使用管理 水资源管理 气候变化减缓与适应	合规内控体系 碳盘查报告 工厂运营区域水资源风险评估 环境信息公示
合作伙伴	研发创新与知识产权保护 可持续供应链管理 循环经济	行业交流 责任商业联盟（RBA）认证本土供应商多元化 供应商社会责任审核机制
社区及公众	社区与公益 排放物与废弃物管理	社区活动、志愿者活动、公益活动、社会事业支持项目等 环境信息公示

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	研发创新与知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	气候变化减缓与适应	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
5	能源使用管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	可持续供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
7	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
8	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
9	商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
10	信息安全与隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
12	清洁技术机遇	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
13	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
14	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	排放物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
16	风险合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
17	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	公司治理	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/

备注：本公司编制本报告严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关规定，现就相关议题说明如下：

1）生态系统和生物多样性保护：在生物多样性保护方面，公司五大工厂均位于工业地块内，不涉及生态保护红线、水源地保护区等管控要求。

2）乡村振兴及社会贡献为非财务重要性议题或者影响重要性议题，但公司仍然对实践活动进行适当披露。

3）科技伦理：公司核心业务集中于半导体晶圆的生产制造，不涉及该议题。

4）平等对待中小企业：截止2025年底，公司应付账款（含应付票据）余额不超过300亿元或占总资产的比重超过50%。

A股代码：688347　A股简称：华虹公司　公告编号：2026-016
港股代码：01347　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开董事会，审议通过了关于变更公司名称、证券简称、修订公司组织章程细则的议案，该议案尚需提交公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情况公告如下：

一、变更公司名称、证券简称的相关情况

（一）变更情况

华虹半导体有限公司（“本公司”，连同其子公司统称“本集团”）董事会（“董事会”）建议将本公司之中文名称由“华虹半导体有限公司”更改为“华虹宏力半导体有限公司”（繁体中文：華虹宏力半導體有限公司），并将本公司之英文名称由“Hua Hong Semiconductor Limited”更改为“Hua Hong Grace Semiconductor Limited”；中文证券简称由“华虹公司”改为“华虹宏力”（繁体中文：華虹宏力），英文股份简称改为“Hua Hong Grace”，公司证券代码保持不变。

（二）变更原因

董事会认为，建议更改公司名称将通过使本公司与其主要运营子公司的名称保持一致，并统一沪港两地股票简称，从而更好地反映与传播本集团的企业形象。因此，董事会相信，建议更改公司名称有利于本集团之未来业务发展，且符合本公司及其股东之整体最佳利益。

二、公司组织章程细则修订情况

因公司名称变更，公司将同时修订公司组织章程细则（“《公司章程》”）中相关条款，主要修订内容如下：

编号	现行《公司章程》	编号	对现行《公司章程》的建议修订
−	公司条例 （第622章） 公众股份有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 之 组织章程细则 （经于二零一四年九月二十日通过之特别决议案采纳，经于二零二一年六月二十七日通过之特别决议案修订，自公司股票于上海证券交易所科创板上市之日起生效及于二零二五年五月八日通过之特别决议案修订）	−	公司条例 （第622章） 公众股份有限公司 HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹宏力半导体有限公司 之 组织章程细则 （经于二零一四年九月二十日通过之特别决议案采纳，经于二零二一年六月二十七日通过之特别决议案修订，自公司股票于上海证券交易所科创板上市之日起生效，于二零二五年五月八日通过之特别决议案修订及于二零二六年[●]月[●]日通过之特别决议案修订）
1.	（a）于本章程细则中，下列词语须具有以下涵义： …… 「本公司」指 Hua Hong Semiconductor Limited 华虹半导体有限公司； ……	1.	（a）于本章程细则中，下列词语须具有以下涵义： …… 「本公司」指 Hua Hong Grace Semiconductor Limited 华虹宏力半导体有限公司； ……
3.	公司名称为「HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司」。	3.	公司名称为「Hua Hong GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹宏力半导体有限公司」。

除上述修订和格式自动调整外，《公司章程》中其他内容不变。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

三、其他事项及风险提示

本次变更公司名称及证券简称系为更好地反映公司的企业形象，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司将于股东周年大会审议通过后及时向香港公司注册处办理变更公司名称及修订《公司章程》的手续，上述变更最终以有权核准该事项的主管部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

公司将在公司名称变更登记手续完成后，向上海证券交易所及香港联合交易所有限公司申请办理公司证券简称变更手续，上述变更最终以上海证券交易所及香港联合交易所有限公司核准的内容为准。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026年3月27日

公司代码：688347　公司简称：华虹公司

华虹半导体有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会讨论决定，2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用　□不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	Daniel Yu-Cheng Wang（王朗）	钱蕾
联系地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电话	86-21-38829909	86-21-50809908
传真	不适用	不适用
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、功率器件等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。

2、研发模式

公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理，建立了较为完善的研发体系及项目管理流程，明确项目组成员职责及目标，从项目的立项、研发及结项全过程进行规范，并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。

3、采购模式

公司采用集中采购制度，由采购部门向合格供应商采购半导体晶圆代工及配套服务所需的原物料、设备及技术服务等。为提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制，公司已建立完善的采购管理体系和规程：

库存类请购由物料计划部门根据生产计划、库存量和交货周期提出；非库存类请购需求由请购部门在预算额度内根据实际需求以请购单方式提出。

收到请购需求后，采购部门核对请购单准确性，确认无误后依据采购需求比选供应商，通过询价、报价、议价或招标等作业程序，与供应商签署采购订单并负责交期跟催。物流部门负责来料的收存工作，品保部门负责来料质量检验。

对于工程、设备和服务采购，采购人员凭请购部门签核的完工通知单和或验收签核文件办理请款作业；对于其他项目采购，采购人员凭系统收货确认在请款系统中开立请款申请单。请款申请单核准后，采购人员连同发票交由财务进行付款作业。

4、生产模式

公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划（即先期生产计划，依据市场预测与产能情况规划产品生产计划），按客户订单需求进行投产，具体如下：

公司产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段，分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段。

（1）生产策划阶段

在生产策划阶段，销售部门提供从客户处获取的未来的业务预测以及与客户达成的商业计划，计划部门按照业务预测以及产能规划，根据客户需求、客户订单、产能和工艺技术准备情况，制定主生产计划。

（2）生产准备阶段

在生产准备阶段，物料规划部门根据主生产计划制定原材料计划并协同采购部门及时准备原材料。生产计划部门根据主生产计划及原材料计划制定投产计划。

（3）生产过程管理阶段

在生产过程管理阶段，生产部门根据主生产计划及投产计划安排和管理生产，生产计划部门监督生产周期、生产进度、产量等指标，品质管控部门负责产品的质量管控。

（4）产品入库阶段

在产品入库阶段，完成全部生产流程的产品经检验合格后入库。

5、销售模式

公司采用直销模式开展销售业务，与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案，最终达成与客户签订订单。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

从宏观经济情况来看，全球经济继续呈现“脆弱复苏、分化加剧”的特征，地缘冲突持续扰动叠加关税政策冲击、供应链重构等因素影响，导致全球需求承压。根据IMF的预计，2025年全球GDP增速达到3.2%。随着全球通胀压力显着缓解，多数经济体央行开启宽松周期实施降息政策，叠加人工智能投资热潮、绿色转型推进及新兴市场增长动能释放等因素，为经济复苏提供了关键支撑。

2025年全球半导体市场高速发展，AI及数据中心的强力需求带动逻辑与存储器等芯片市场快速增长；随着部分区域消费和产业链需求回暖以及产品升级迭代，成熟制程芯片市场复苏。据IBS2026年的数据显示，2025年全球半导体市场销售额约为7,435亿美元，同比增长18.7%。

晶圆代工行业源于半导体产业链的专业化分工，晶圆代工企业不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片产品公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的技术储备、资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

中国大陆晶圆代工企业起步较晚，但在国家政策的支持下，随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，以及终端应用市场规模的扩大，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升。叠加国内产业链上下游企业、国外有本地化市场需求企业对供应链安全与稳定的重视，中国大陆晶圆代工行业仍将保持快速发展的趋势，并实现技术平台、工艺能力的不断进步。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

华虹公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有行业领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球纯晶圆代工企业最新公布的2025年销售额情况，华虹公司仍位居全球第五位，在中国大陆企业中排名第二。

2026年，公司将继续聚焦工艺能力和产能建设，打造与自身行业地位相匹配的核心竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体晶圆代工行业在新技术领域的发展情况

信息化、数字化、智能化、网联化等市场发展趋势，带动了全球半导体技术的不断迭代与创新，对除了逻辑电路以外的其他集成电路和半导体器件类型同样提出了更高的技术要求，嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺技术得以快速发展以适应不断更新的市场需求。技术创新从单纯尺寸微缩转向器件性能、材料、架构、封装、功能集成等多维度创新。

（2）半导体晶圆代工行业在新产业的发展情况

随着AI、新能源汽车、工业智造、通讯、物联网、新能源等新兴产业的蓬勃发展，芯片作为智能硬件的核心部件，其应用几乎无处不在，在新产业的诞生和发展过程中承担了重要角色。与此同时，新产业的发展也会对芯片的性能、功耗、尺寸等不断提出新的需求，促进晶圆制造技术的突破和工艺平台的丰富，为半导体晶圆代工行业带来新的机遇。

（3）半导体行业在新业态与新模式的发展情况

半导体中游产业在发展初期，由于相关技术被少数国际大型企业掌握，而生产所需的设备、材料、工艺技术等又具有高度专业性等原因，行业内企业主要采用垂直整合模式（IDM模式）。伴随产业规模扩大、技术进步与市场多样化需求的兴起，半导体中游逐渐由设计、制造以及封装测试只能在公司内部一体化完成的IDM模式演变为多个专业细分产业，行业开始呈现垂直化分工格局。此外，全球区域化布局提速，全球各区域加大半导体产能建设，供应链的深度重构，既推动了全球半导体产业在技术研发、产能布局上的协同联动，也让各区域、各环节的技术竞争与市场角逐进一步加剧。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	100,123,291,330.96	87,935,231,475.57	13.86	76,226,351,074.40
归属于上市公司股东的净资产	45,160,290,354.51	43,602,332,245.07	3.57	43,354,252,355.10
营业收入	17,291,450,660.78	14,388,307,712.89	20.18	16,231,874,037.72
利润总额	−651,006,116.35	−988,318,058.16	不适用	1,177,544,111.38
归属于上市公司股东的净利润	376,611,422.56	380,576,197.36	−1.04	1,936,230,415.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,938,871.34	245,280,545.42	−6.66	1,614,028,155.76
经营活动产生的现金流量净额	5,065,421,315.35	3,608,289,668.76	40.38	5,104,987,996.61
加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.88	减少0.03个百分点	6.49
基本每股收益(元／股)	0.22	0.22	−	1.31
稀释每股收益(元／股)	0.22	0.22	−	1.30
研发投入占营业收入的比例(